

2012年3月期 通期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2012年5月9日

代表取締役社長 赤尾 泰

エグゼクティブサマリー

I. 2012年3月期 通期 決算概要

- 第4四半期は、売上高はほぼ想定どおりも、営業損益は生産減に伴う利益減などにより想定を下回った
- 通期では、震災、タイの洪水影響、欧州・中国を中心とした市況悪化などにより前年度比で売上高は大幅に減少、営業損益は研究開発費効率化、販売費及び一般管理費の削減などの費用削減施策を実行したものの、売上減による利益減をカバーするまでには至らず、赤字を計上

II. 事業・生産構造対策の展開とコアコンピタンスの強化

- 事業の選択と集中及び生産構造の最適化を推進中
- 世界No.1シェアを堅持するマイコンをコアコンピタンスとして、自動車分野での不動のポジションを確立

I. 2012年3月期 通期 決算概要

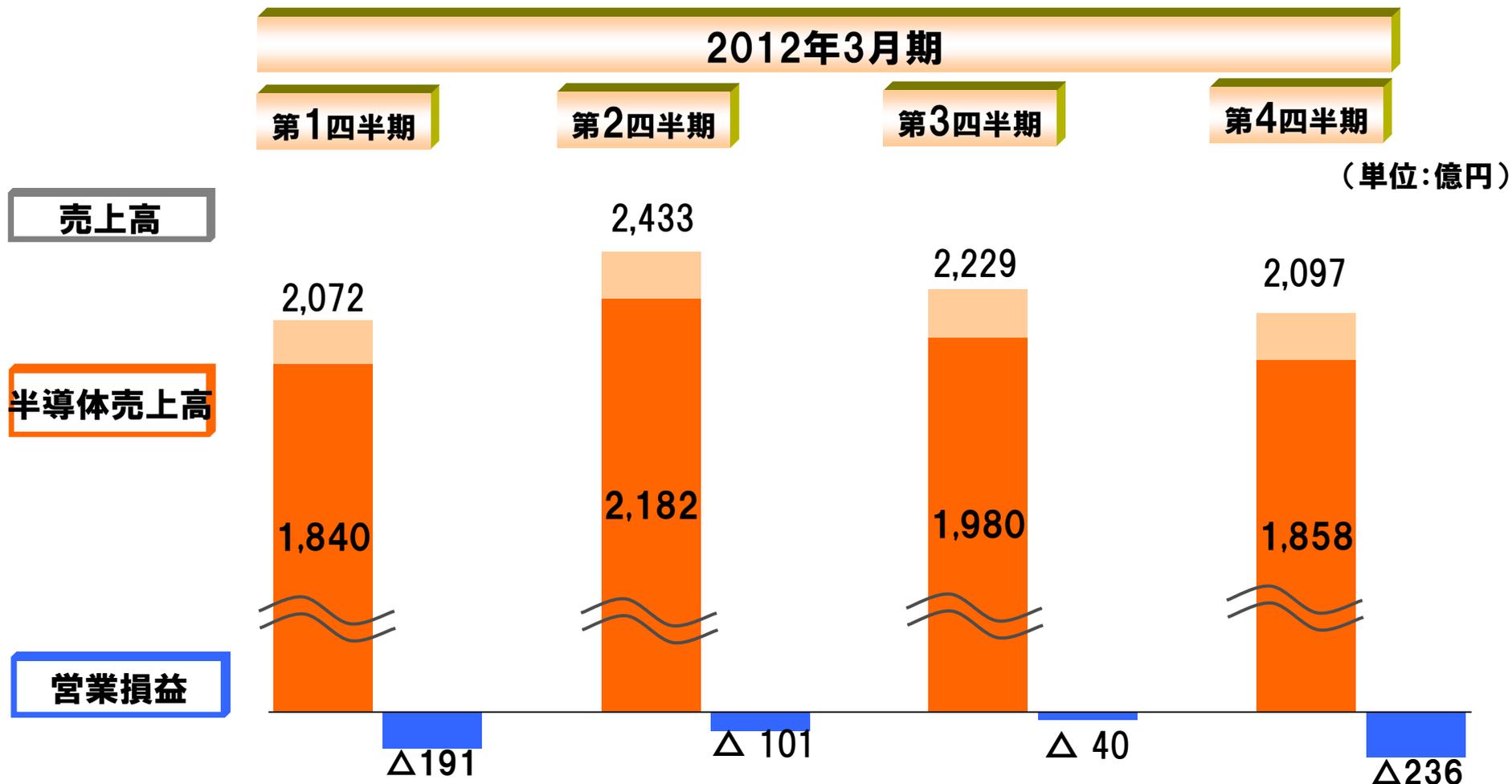
2012年3月期 通期 決算概要

- 半導体売上高は、震災、タイの洪水影響、欧州・中国を中心とした市況悪化による需要減などにより、前期比で2,329億円の減少
- 営業損益は、研究開発費の効率化、販売費及び一般管理費の削減などの費用削減策を実行したものの、売上減による利益減をカバーするまでには至らず、赤字を計上

2012年3月期						
(単位:億円)	第4四半期	前四半期比		通期	前回予想比	前期比
売上高	2,097	△132		8,831	△19	△2,548
半導体売上高	1,858	△122		7,860	△20	△2,329
営業損益	△236	△196		△568	△88	△713
経常損益	△243	△207		△612	△72	△622
当期純損益	△182	△157		△626	△56	524
1US\$=	78円	1円 円安		79円	-	7円 円高
1ユーロ=	102円	3円 円高		109円	-	5円 円高

2012年3月期 四半期業績推移

- 営業損益は、第3四半期にかけて改善傾向にあったものの、生産減などにより第4四半期は悪化



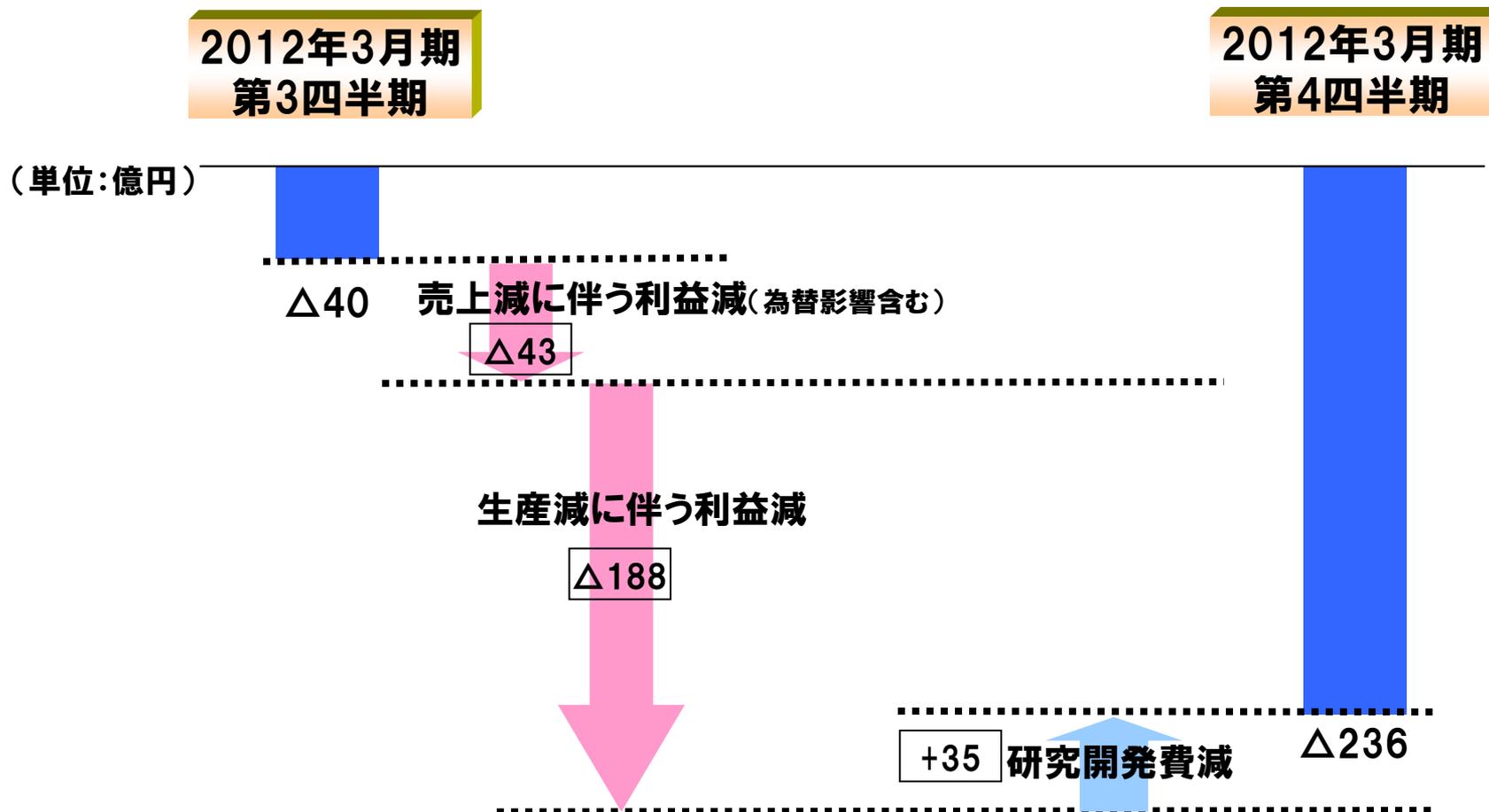
2012年3月期 半導体売上高の事業別状況①

- 第4四半期は、アナログ&パワー半導体が大幅減少の前四半期から+8.6%と回復傾向、マイコンも自動車向けを中心に堅調を維持したものの、SoCが全般的に下げ止まらず、半導体売上高は前四半期比6.1%の減少
- 日系自動車メーカーの増産に伴い、下期にかけて自動車向けマイコンが前年並みの水準に回復したものの、通期の半導体売上高は大幅減

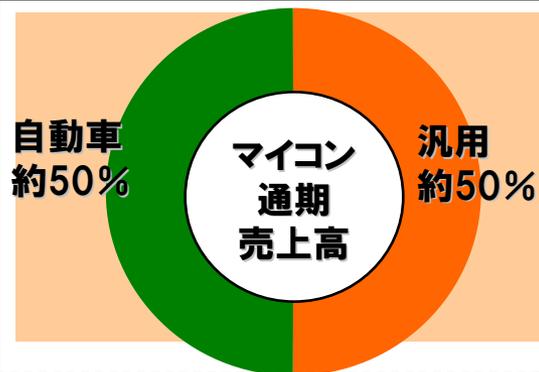
2012年3月期				
(単位:億円)	第4四半期	前四半期比 (%)	通期	前期比 (%)
半導体売上高 計	1,858	△6.1%	7,860	△22.9%
マイコン	830	△6.3%	3,363	△12.4%
アナログ&パワー 半導体(A&P)	592	+8.6%	2,438	△22.9%
SoC	428	△19.9%	2,012	△35.5%
その他半導体	9		48	

2012年3月期 第4四半期営業損益（前四半期比）

- 売上減に伴う利益減、生産減に伴う利益減により、196億円の悪化

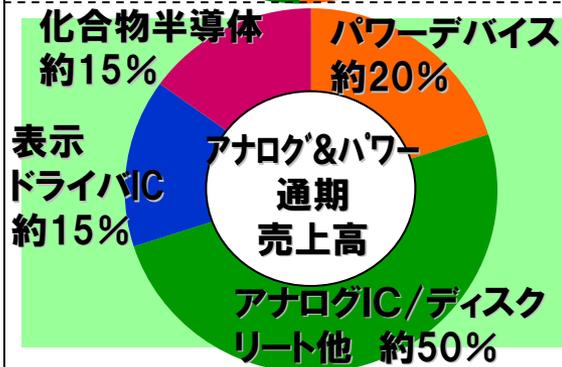


2012年3月期 半導体売上高の事業別状況②



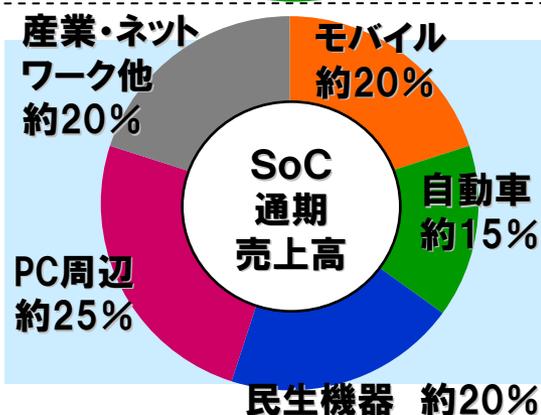
➢ 汎用マイコンは、震災影響による売上急減に、タイの洪水影響や世界的市況悪化が拍車をかけ、前期比で約20%の売上減。産業・民生・PC周辺機器など全分野で売上減となり、成長市場としてシェアを高めていた中国市場の落ち込みの影響も大きい

➢ 自動車マイコンは、震災影響を受け第1四半期に売上が急減したものの、日系自動車メーカーの増産に伴い復調し、ほぼ前期並みの売上に回復



➢ 自動車向けパワーデバイスとアナログICは、日系自動車メーカーの生産回復につれ前期比で売上増なるも、PCなどその他用途向けでは、震災、タイの洪水影響、市況悪化の影響を受け、前期比で20%以上の売上減。ただし、第4四半期からPCなどその他用途向けで回復の兆し

➢ 表示ドライバICは、中小型パネル向けは需要増傾向にあるが、撤退を決めた大型パネル向けの売上減により、前期比で約30%の売上減



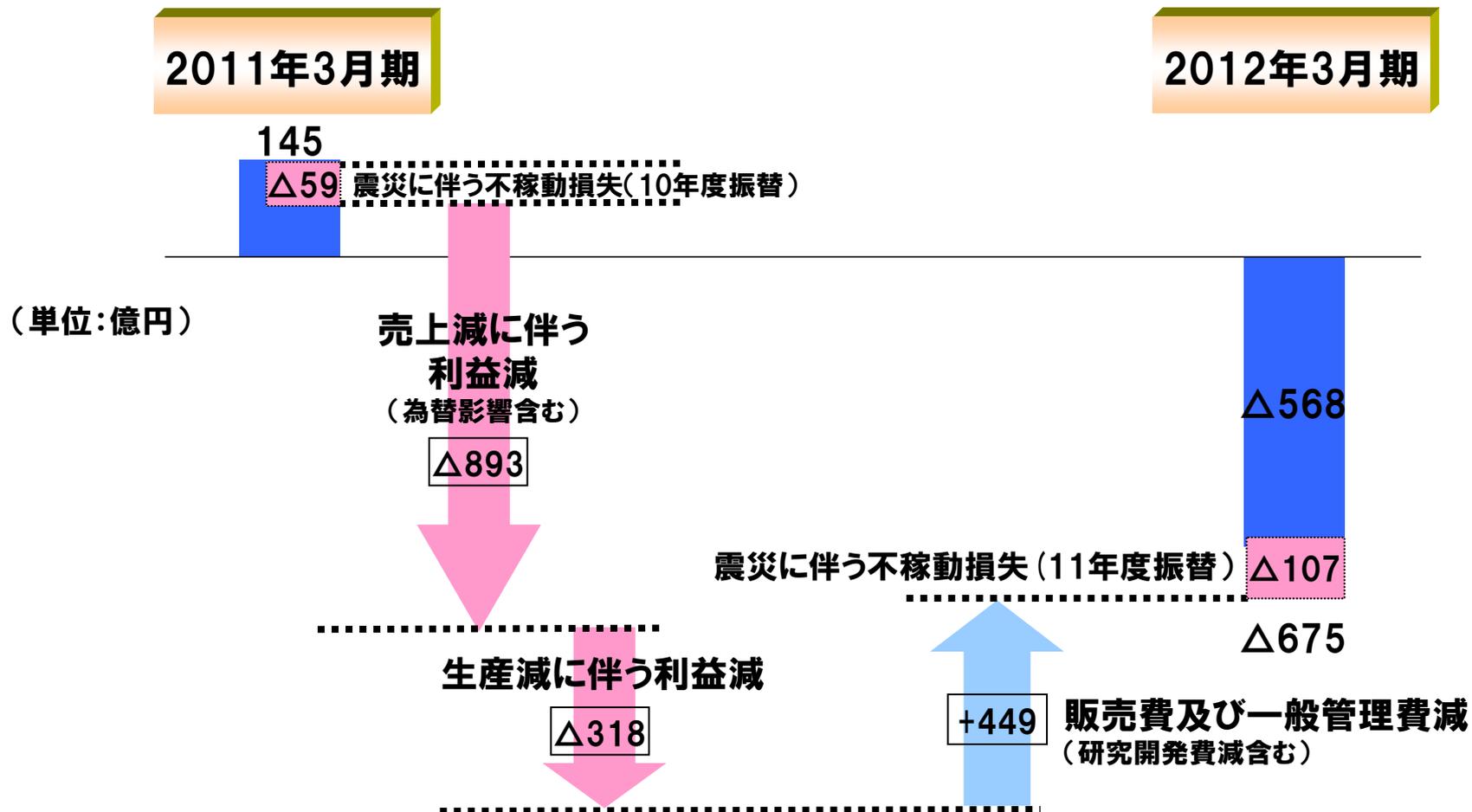
➢ モバイル向けは、従来型携帯電話での落ち込みが大きく、前期比で売上がほぼ半減

➢ 自動車向けは、震災影響を打ち消す需要回復が続き、前期比で売上増

➢ 民生・PC周辺機器向けは、市況悪化に加えて、テレビなど一部事業の縮小も進めた結果、前期比で30%以上の売上減

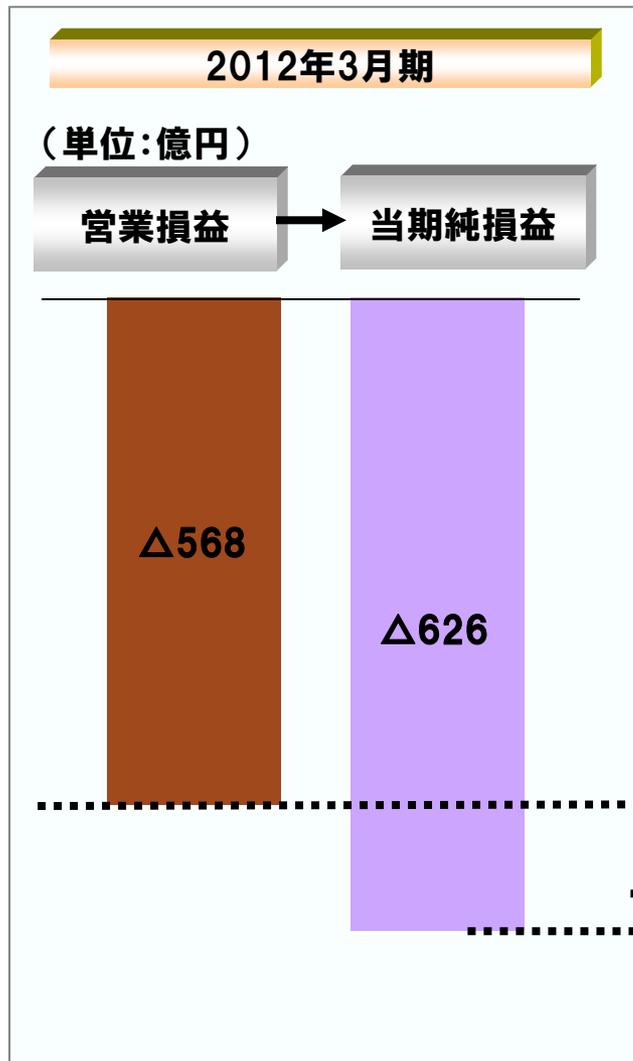
2012年3月期 通期営業損益（前期比）

- 売上減、生産減に伴う利益減を、研究開発費の効率化を含む、販売費及び一般管理費の削減などによりカバーしたものの、営業損益は赤字を計上



2012年3月期 当期純損益の状況

- 災害損失引当金戻入、パワーアンプ事業譲渡などにより、213億円の特別利益を計上
- 震災に伴う不稼動損失などにより、197億円の特別損失を計上



<特別利益の主な内訳>

- ・災害損失引当金戻入額 約135億円
- ・事業譲渡益 約50億円
- ・その他 約28億円
- ・計 約213億円

<特別損失の主な内訳>

- ・災害による損失 約128億円
- ・その他 約69億円
- ・計 約197億円

特別損益 +16億円

営業外損益
△45億円

法人税等、少数株主損益
△30億円

バランスシートの状況

(単位:億円)	11/4期首	11/12末	12/3末
総資産	11,450	9,017	8,582
うち 現金及び現金同等物	3,373	1,578	1,319
うち たな卸資産	1,234	1,577	1,518
負債合計	8,540	6,654	6,317
うち 有利子負債	3,782	2,633	2,583
株主資本	3,060	2,616	2,434
純資産合計	2,911	2,363	2,265
D/Eレシオ(グロス)	1.33倍	1.15倍	1.19倍
D/Eレシオ(ネット)	0.14倍	0.46倍	0.58倍
自己資本比率	24.8%	25.3%	25.4%

(注)①現金及び現金同等物:「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。
 ②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「長期借入金」
 ③自己資本:「株主資本」、「その他の包括利益累計額」 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本

キャッシュ・フローの状況

- 税金等調整前当期純損失の計上、有形固定資産の取得による支出などにより、通期のフリー・キャッシュ・フローは648億円の赤字

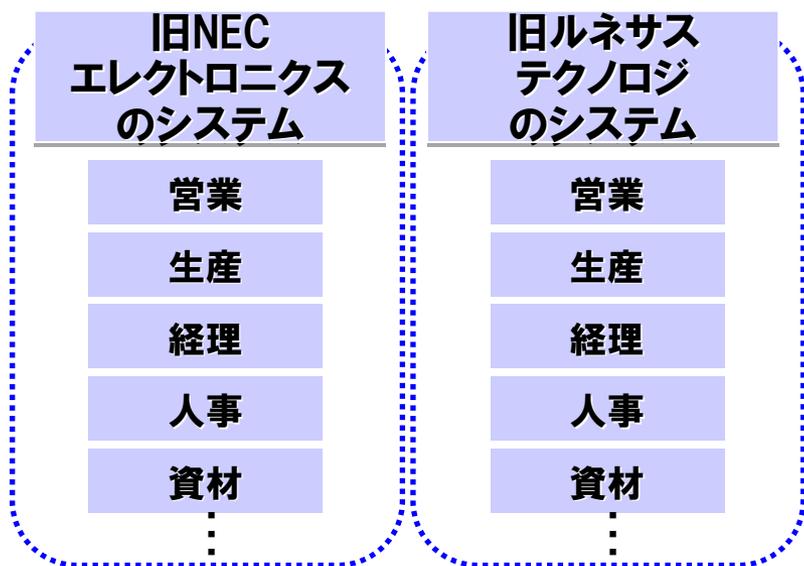
2012年3月期					
(単位：億円)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期
営業活動による キャッシュ・フロー	△292	80	180	△66	△97
投資活動による キャッシュ・フロー	△148	△178	△152	△73	△551
フリー・ キャッシュ・フロー	△440	△97	29	△140	△648

II. 事業・生産構造対策の展開とコアコンピタンスの強化

事業統合3年目を迎えて — 新統合システムのスタート

- 事業統合の最終段階として、営業・生産・経理・人事など会社運営全般にわたる制度を一本化
- ITシステムを統合し、4月から新システムを稼働
- 早期のシステム統合により、費用対効果の高い事業運営を進める

事業統合後 (2010年4月～2012年3月)



ディスシナジー

- 旧2社のシステムの並行運用によるコスト増
- 2つの方式・ルールでの業務実施による非効率

- グローバル規模で統合
- 既存資産を有効活用
(システムの大規模新規開発不要)

2012年4月～



シナジー

- システム運用コスト削減
- 業務効率化とリソースの有効活用
- 迅速かつ的確な経営判断への貢献

事業・生産構造対策の展開

■ 事業の選択と集中及び生産構造の最適化を推進中

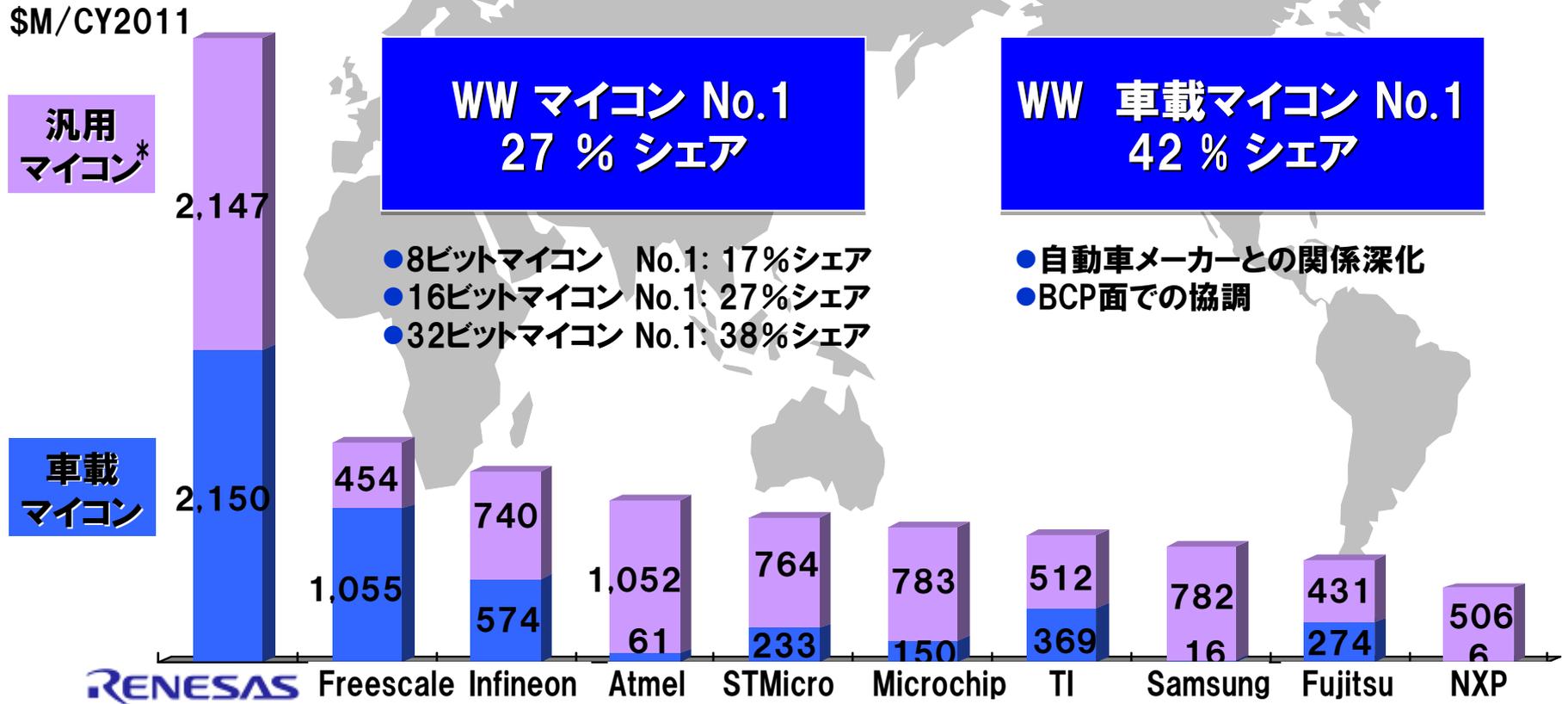
2011年度中に実施・発表した事業・生産構造対策	
事業	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーアンプ事業を村田製作所に譲渡（12年3月完了） ・大型表示ドライバIC事業撤退（12年3月新規開発完了） ・コンシューマ向けなど短ライフサイクルのSoC製品の集約
生産 (前工程)	<ul style="list-style-type: none"> ・ローズビル8インチライン*1をTelefunkenに譲渡（11年5月完了） ・甲府6インチライン*2を縮小（11年9月完了） ・高崎5インチライン*3を縮小（11年12月完了） ・滋賀5インチライン*4を集約（12年3月完了） ・津軽6インチライン*5を富士電機に譲渡（12年7月予定）
生産 (後工程)	<ul style="list-style-type: none"> ・閉鎖した福岡工場*6の土地を売却（11年9月完了） ・パワーアンプ生産の長野工場*7を村田製作所に譲渡（12年3月完了） ・青梅工場*8を閉鎖（12年3月完了）

*1) ルネサス エレクトロニクス アメリカ ローズビル工場(アメリカ、カリフォルニア)
 *2) ルネサス エレクトロニクス 甲府工場(山梨県甲斐市)
 *3) ルネサス エレクトロニクス 高崎工場(群馬県高崎市)
 *4) ルネサス関西セミコンダクタ 滋賀工場(滋賀県大津市)

*5) ルネサス北日本セミコンダクタ 津軽工場(青森県五所川原市)
 *6) ルネサス セミコンダクタ九州・山口 福岡工場(福岡県柳川市)
 *7) ルネサス東日本セミコンダクタ 長野デバイス本部(長野県小諸市)
 *8) ルネサス東日本セミコンダクタ 東京デバイス本部(東京都青梅市)

コアコンピタンスの強化 – マイコン：世界No.1を堅持

- 2011年のマイコンシェアは27%と世界No.1を堅持
- 震災からの復旧を通して、自動車メーカーとの関係が強化されると共に、車載マイコンでのシェアNo.1も堅持し、圧倒的優位なポジションは変化なし



*) 汎用MCU: 車載向けMCU売上を除く、その他アプリケーション向けマイコン市場

出典: IHS iSuppli, Annual 2011 Semiconductor Market Share

コアコンピタンスの強化

–マイコンNo.1の源泉：成長市場に最適な3コア

- マイコンコアを3コアに集約し、リソースを集中
- 成長市場の幅広いアプリケーションをカバーし、各々において最適な強みを発揮

ローエンド
(8/16 bit)



**狙う
成長市場**

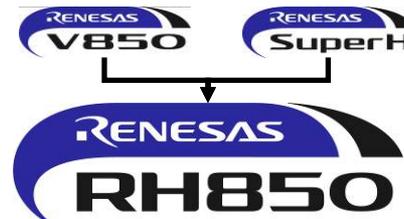
新興国市場
–小規模システム向け

ミッドレンジ
(32bit CISC*1)



スマート社会市場
–インバータ機器など

ハイエンド
(32bit RISC*2)



自動車
–エンジン制御など

フルラインアップ –各アプリケーションに最適なメモリサイズ・パッケージ (ピン数) を提供

低消費電力

–RL78、RX、RH850
それぞれで業界最小の
消費電力を実現



–レモン1個で、超低電力マイコンの動作を実証

–不良率0.4ppm (1/250万個の不良品) を実現
–高信頼性や手厚いサポート実績に対し、
自動車/電装メーカーなどからの表彰・感謝状

高信頼性

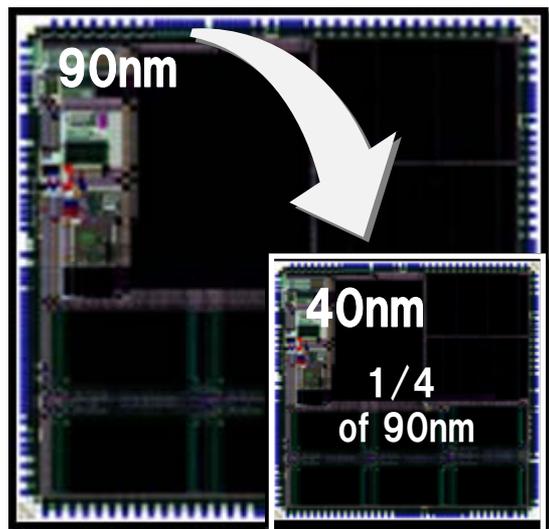
*1) CISC:Complex Instruction Set Computer, *2) RISC: Reduced Instruction Set Computer

コアコンピタンスの強化

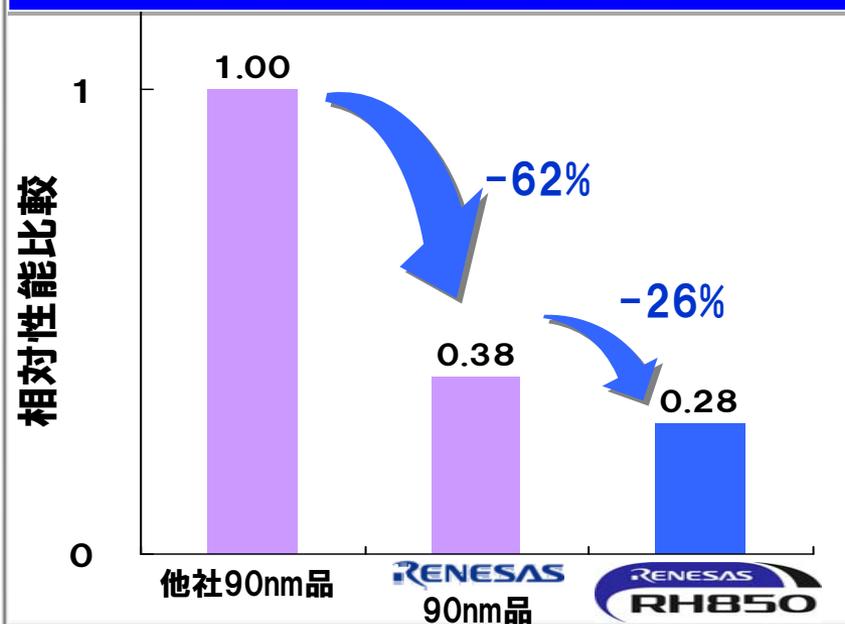
—RH850: 自動車分野で他社の追隨を許さない世界初40nmマイコン

- 世界に先駆けて、最先端の40nmプロセスのフラッシュマイコンを開発
- 独自開発のメモリセル技術「MONOS*」構造のフラッシュメモリを内蔵し大容量プログラム格納のみならず、高信頼性・高速動作・低消費電力を実現

世界最小メモリセル



世界最小の消費電力



高信頼・高速・低消費電力が要求される自動車に展開、採用拡大中
(12年度上期サンプル出荷、マルチファブにて量産開始予定)

*) MONOS: Metal-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon

コアコンピタンスの強化

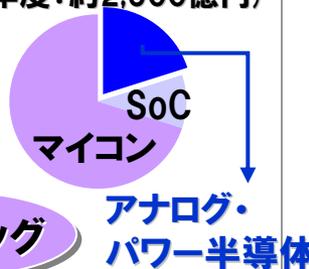
－アナログ・パワー半導体：自動車など成長市場への攻勢

- 世界No.1マイコンとの組み合わせにより、アナログ・パワー半導体の自動車分野での商機が拡大、売上最大化を狙う
- 低耐圧～高耐圧まで、3年間でパワー半導体1,000製品開発を目指し、開発リソースを集中してラインアップ拡充中(現在650製品開発済み)
- スマホ・タブレットPCの成長市場における、需要の確実な取り込みと掘り起こし

自動車 (HEV/EV含む)



自動車向け
半導体売上
(11年度:約2,500億円)



- パワートレイン
- シャーシ
- エアバッグ
- ボディ
- ブレーキ
- 車載ネットワーク

当社の提供するアナログ・パワー半導体製品
パワーMOSFET、IPD、IGBT、
ミックストシグナルIC、
通信ドライバ(CAN、FlexRay)、
フォトカプラ

スマートフォン・ タブレットPC市場



中小型表示ドライバ

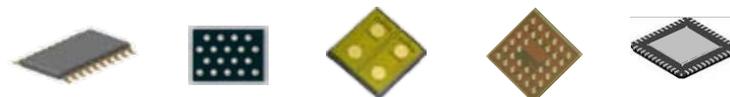
世界シェア
No.1へ

電池MOSFET

電池監視IC

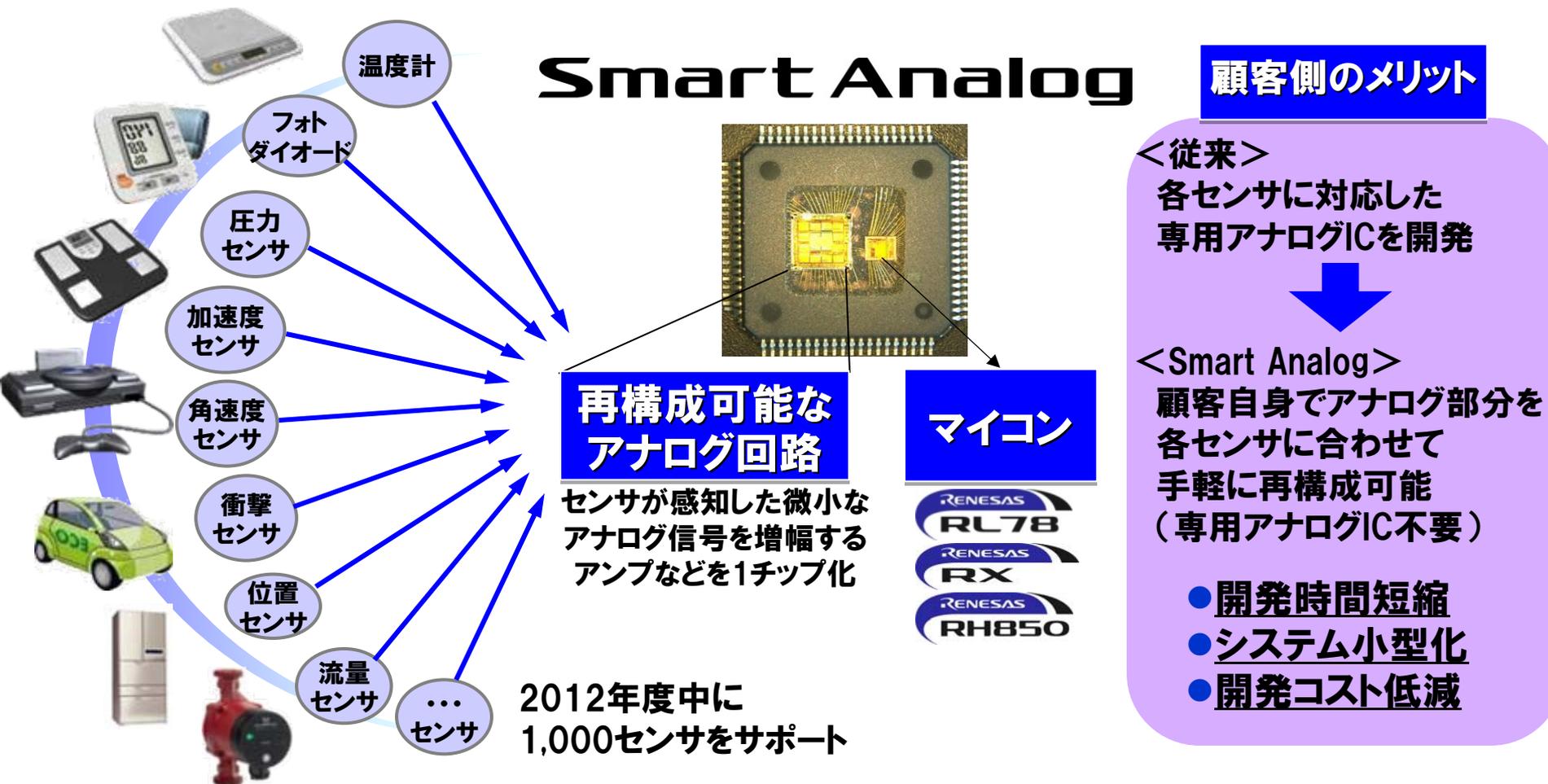
手振れ補正IC

ワイヤレス給電



コアコンピタンスの強化 – Smart Analog: マイコンとアナログの融合

- マイコンと再構成可能なアナログ回路を組み合わせたSmart Analogを開発
- スマート社会を構成する各種機器に搭載される複数センサに1つで対応可能し、顧客側でのシステムの開発時間短縮と小型化に貢献



LTEモデム：更なる成長に向けた挑戦

- 世界最小・最高速スループットのLTEモデムと最適なアプリケーションプロセッサのチップセット、または1チップ化製品によりスマートフォン市場を攻略

モデムプラットフォーム

- 競合他社サイズ比*40%の世界最小・高速スループット・低消費電力のLTEモデム(DBB)を実現
- アプリケーションプロセッサ(APE)について、顧客は当社製品以外に、NVIDIA®社やTexas Instruments(TI)社などの製品も選択可能
- ターゲットはハイエンドスマートフォン、タブレットPC、データカード等



モバイルプラットフォーム

- LTEモデム (DBB) とアプリケーションプロセッサ (APE) を1チップ化
- 当社初の28nm製品として、12年度第3四半期にボリュームゾーン of スマートフォン向けに量産予定



スマートフォンに加え、通信機能を搭載する多種モバイル端末に展開

- 現在14社 (内9社が海外) にデザインイン済み

*) 当社と同じ45nm CMOSプロセスで製造された他社のLTEマルチモードモデムと比較

NVIDIA, Tegraは米国及びその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。OMAPはTexas Instrumentsの商標です。

2013年3月期 業績見通しについて

- 東日本大震災やタイの洪水影響、欧州・中国を中心とした経済環境の悪化、長引く円高の影響などにより、2012年3月期の当社の連結売上高は、前期比で約22%の大幅減収となり、626億円の当期純損失を計上しました。
- 足元の半導体市況に関しては、一部で改善の兆しが見られるものの、全般的には未だ厳しく、先行き不透明な状況が続いております。このような中、当社としましては、今暫く、今後の半導体市況について見極める必要があると考えています。また、当社は昨年8月の事業方針発表以降、安定した利益を上げるべく事業ポートフォリオの見直しを進めており、その影響も十分勘案する必要があると考えています。
- よって、現時点において、2013年3月期の連結業績予想値は開示しておりません。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

